⑨ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62 - 179482

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)8月6日

A 63 C 5/052

6777-2C

審査請求 有 発明の数 1 (全2頁)

段発明の名称 スキー

②特 願 昭61-20340

②出 願 昭61(1986)2月1日

②発明者羽生田康二長野市真島町真島174番地

⑪出 願 人 羽 生 田 康 二 長野市真島町真島174番地

明 細 割

公明 1. 考案の名称

スキー

3. 孝様の許細な説明

第1回は従前の一実施例の側面断面図である。ス キー1にくつ金異2を散けて且つ水平地面3にス キー1の滑走面を辿くとその前部および後部に接 地点 4、接地点 1 非接地点 c を有して露曲を形 成し且つ両側面に桜袋なエッチを設けて、スキー 1は構成されている。第2図は第1図の底面図で ある。庇笛はスキー1の滑走面であって、その中 央部分に鞍長の溝(を設けて且つ前部の松地点。 には前記簿は違っしていない。両傾面にはエッチ • を取けてある。 2 はくつ金具である。 併走回転 を左または右に回転する際に回転の外側になって いるエッチ●を響面に対してその効果を外すし回 時に削部扱地点。を回転の支点になる頃に体重を 掛けながら回転をする技術の経帯は、ハードな様 習訓練が必要である。第3図は本海線の一災脳例 の側面断面図である。 基本的には第1図のスキ - 1 と阿碌であるが、 別記した滑走回転を巡めて 容易に可能ならしめるためにスキー1の前部接地 点。の両側面エッチに凸状エッチを設けてこの前 部接地面 ● の資定回転の支点の効果を増強させた

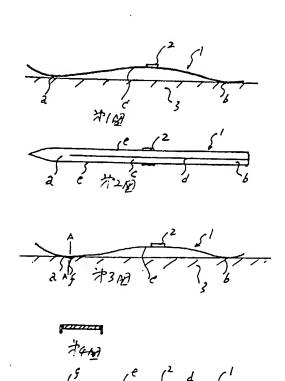
ものである。滑走回転の際に左または右へ回転動 作(クリスチャニア時のスキーのテール綴り体道 を抜きつづいてその回転の外側に体重を掛けひさ をその回転の内側へ押し込み曲げ滑走する)を該 凸状エッチによってスキーテールへの荷魚を抜き テール扱りが極めて容易に実現出来る。前部接地 点。の両側における該凸状エッチェは滑走中の安 全と回転の支点効果とは比例し難い点があるので 高点資産を基本に考へて該回転の支点の効果を大 をくするとその支点における抵抗が増大し転貸し 危険であるのでクリスチャニアのテール振りの起 動が危険でない範囲内で容易に出来る滑走抵抗を 示していれば充分である。第4図は第3図のAー A 部分の前面図である。 第5 図は第3 図の底面図 である。以上の様にして、本等以の一実態例によ れば、スキー1の削部接地点。の両側面に凸状エ ッチェを設けて滑走回転を振めて容易に出来てス キー初心者 初級者であっても、従前のハードト レーニングを短縮して、スキーの技術を早く修得 可能になった等の特徴を有している。

4. 図面の簡単な説明

第1 図... 従前の一実麻例の側面断面図。第2 図... 第1 図の底面図。第3 図... 本学家の一共 通例 の側面断面図。第4 図... 第3 図の A — A 部分の前 面図。第5 図... 第3 図の佐面図。

1 … スキー。 2 … くつ金具。 3 … 水平地面。 a … 向部接地面。 b … 後部接地面。 c … 非接地面。 d … 被長の降。 e … 両側面のエッチ。 f … 前部接地面。の両側面に有した凸状エッチ。

等 好 実用新業登錄出版人 羽 生 田 : 庭 二



1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-022051

(43)Date of publication of

25.01.1989

application:

(51)Int.CI.

H01L 21/94

H01L 21/76

(21)Application

62-179482

(71)

MATSUSHITA ELECTRIC IND

number:

(22)Date of filing:

17.07.1987

(72)Inventor:

Applicant:

TAMAOKI NORIHIKO

CO LTD

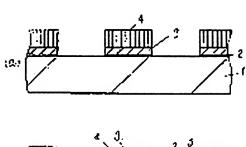
KUBOTA MASABUMI

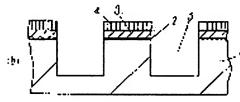
(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

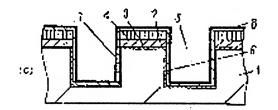
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the acid resistant mask from being etched in the later isotropical etching process by a method wherein, after a silicon nitride film as a second acid resistant film is formed on the whole semiconductor substrate surface, the surface of this silicon nitride film is oxidized to form a silicon oxide film as an anti-etching mask which is thin and has no pin holes.

CONSTITUTION: On an N-type substrate 1, a thermal oxide film 2, a silicon nitride film 3 and a silicon oxide film 4 are sequentially formed, and with the silicon oxide film 4 as a mask they are etched to form opening parts 5. With the silicon nitride film 3 as a mask a thermal oxidation is performed to form a thermal oxide film 6 on the side and bottom of the opening parts. Thereafter, a silicon nitride film 7 is formed on the whole surface by a low pressure CVD method or the like, and subsequently a heat treatment is performed in an oxidation atmosphere to oxidize the surface of the silicon nitride film 7, thereby forming a silicon oxide film 8. With this, even if there are pin holes in the silicon







oxide film which is later deposited on the silicon nitride film 7, the etching of the silicon nitride film 7 is prevented since the silicon oxide film 8 acts as an anti-etching mask in the isotropical etching process.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]